

特点:

- 良好的幅度不平衡度: 典型值 $\pm 0.3\text{dB}$
- 低插入损耗: 典型值 1.2dB
- QFN 封装, $4\times 4\times 1.5(\text{max})\text{mm}^3$
- 执行标准为 GJB8481-2015

性能参数: ($T_a=25^\circ\text{C}$)

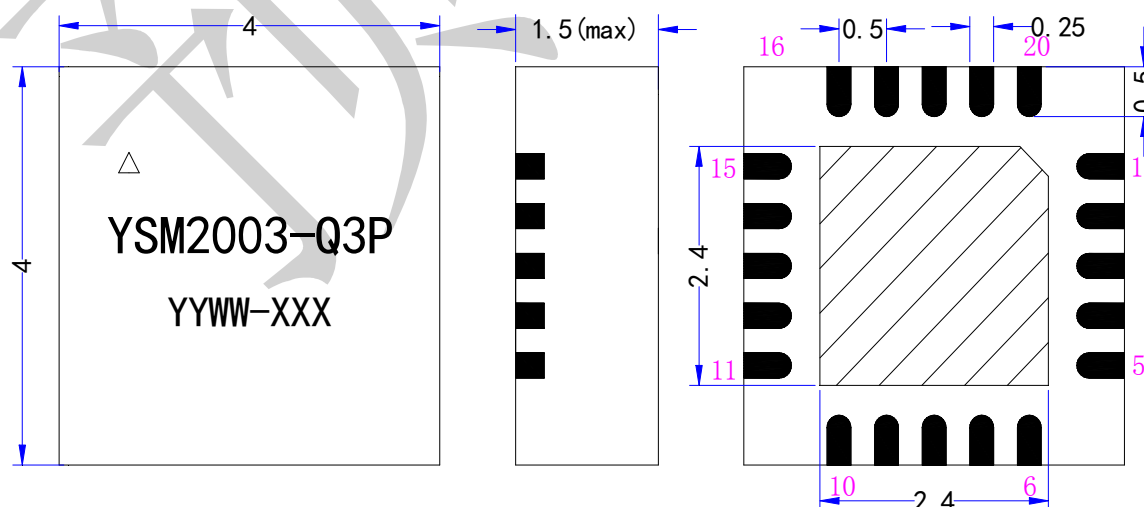
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	$Z_{in}=Z_{out}=50\Omega$	0.5		2	GHz	
插入损耗	IL	$Z_{in}=Z_{out}=50\Omega$ $f=0.5\sim 2\text{GHz}$ $P_{in}=0\text{dBm}$		1.2	2.0	dB	
幅度不平衡度	AU			± 0.3	± 0.6	dB	
输入驻波比	VSWR _i			1.5:1	2.0:1		
输出驻波比	VSWR _o			1.5:1	2.0:1		
隔离度	ISO		15	20		dB	
工作温度	T		-55		+85	$^\circ\text{C}$	
质量	m				1	g	

极限参数表:

参数名称	极限值	单位
储存温度	-55~+100	$^\circ\text{C}$
输入射频功率	27	dBm

封装外形图:

单位: mm 公差: $\pm 0.2\text{mm}$



注: 该产品为塑封封装。

字符标志:

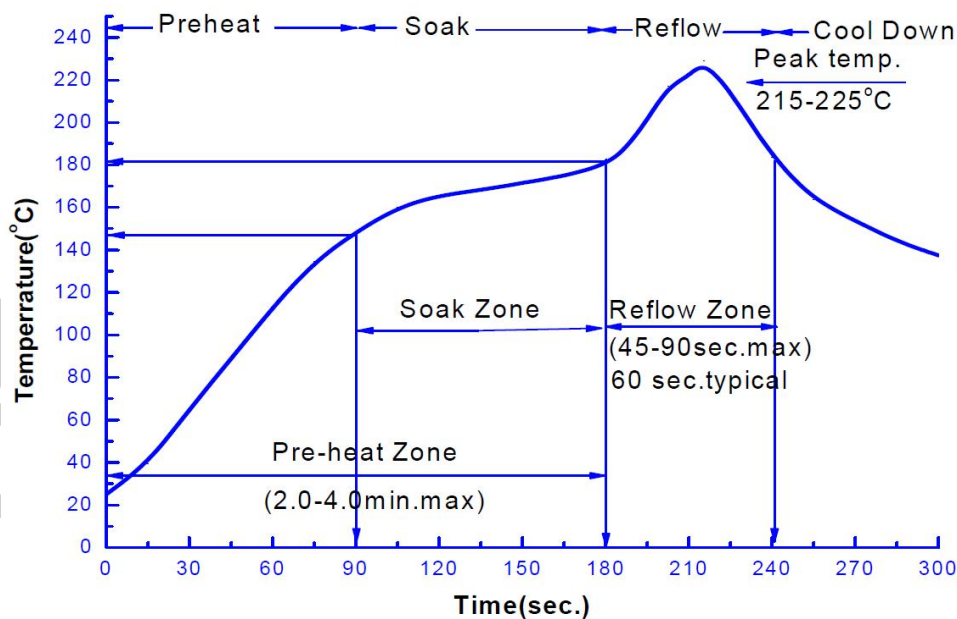
YSM2003-Q3P	产品型号
Δ	1 脚
YYWW	批次号
XXX	序列号

引脚定义:

接口标识	符号	接口说明	备 注
3	RFC	射频公共端口	
11	RF1	射频输出端口 1	
15	RF2	射频输出端口 2	
1/5/6/10/13/16/20/底部	GND	接地	
其它引脚	NC	悬空	

产品使用注意事项:

- 1.产品属于静电敏感器件，耐静电能力 $\leq 250V$ ，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
- 2.产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域）；
- 3.产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183℃回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 230℃。

- 4.如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
- 5.产品禁止采用超声波清洗，避免内部元器件及焊点受力影响可靠性。
- 6.产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
- 7.客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性。